

**推荐** (维持)

## 电子行业动态点评

风险评级：中风险

海外疫情加剧，大陆电子产业“危”“机”并存

2021年5月13日

罗炜斌 (SAC 执业证书编号: S0340521020001)

电话: 0769-23320059 邮箱: luoweibin@dgzq.com.cn 研究助理:

刘梦麟 (SAC 执业证书编号: S0340119070035)

电话: 0769-22110619 邮箱: liumenglin@dgzq.com.cn

### 投资要点:

#### 事件:

- 据媒体消息，台湾地区防疫部门 11 日宣布当日新增 7 例本土新冠肺炎确诊比例，创下单日最高记录，台湾地区流行疫情指挥中心负责人 11 日表示，台湾已进入社区感染阶段。据外媒报道，由于工人因新冠病毒被迫离职，富士康印度工厂 iPhone12 产量已下降 50% 以上。印度南部泰米尔纳德邦宣布，从 5 月 10 日凌晨 4 时起，开始实行为期两周的封锁政策，直至 5 月 24 日，以遏制新冠肺炎疫情蔓延。
- 此外，由于疫情加剧，马来西亚总理穆希丁于 5 月 10 日通过文告宣布，自 5 月 12 日至 6 月 7 日在全国范围内重启“行动管制令”，以遏制新冠疫情蔓延趋势。

#### 点评

- **印度是重要的手机消费市场和生产基地，疫情加剧将对智能手机出货量造成不利影响。**印度是全球第二大手机制造基地，苹果、小米、三星、OPPO、vivo 等全球主要手机品牌均在印度设立手机生产工厂。印度疫情形势加剧，导致苹果主要代工厂鸿海、纬创相继爆出疫情，纬创一度关闭停工 5 天，而富士康在印度的工厂出现大规模感染，目前其负责加工生产的 iPhone 手机减产幅度超过 50%。此外，印度作为全球人口第二大国，疫情也将大幅削弱当地消费者对消费电子的购买需求，预计将对全球智能手机出货造成不利影响。根据 IDC 报告显示，2020 年印度智能手机市场排名前五的手机品牌中，有四个来自中国的品牌，其中小米获得印度智能手机市场 27% 份额，排名第一；三星排名第二，市场份额为 20%，以下分别为 vivo (18%)、realme (13%) 和 OPPO (11%)，若印度疫情持续蔓延，将对国内智能手机出货量造成冲击。
- **台湾为全球半导体晶圆制造中心，若疫情持续将影响全球半导体产能。**台湾是全球最大的晶圆代工基地，根据集邦咨询数据，截至 2020 年前三季度，全球前十大晶圆代工厂中，有四家来自中国台湾，分别为台积电、联电、世界先进和力积点。其中，台积电市场份额高达 56%，位列全球第一。作为全球晶圆代工龙头，台积电在 12 英寸晶圆先进制程领域一家独大，是苹果、AMD 等巨头的主要供应商。大陆部分芯片设计企业也以台积电为主要的晶圆代工厂，若台积电产能受到影响，这些公司将受到负面影响。此外，台湾地区拥有全球最大的半导体封测产能，大陆紧随其后位居第二。

表 1: 全球前十大晶圆代工厂 (2021 年第一季度)

排名	公司	国家或地区	1Q21E	1Q20	YOY	M/S
1	台积电	中国台湾	12,910	10,310	25%	56%
2	三星	韩国	4,052	3,660	11%	18%
3	联电	中国台湾	1,603	1,402	14%	7%
4	格芯	美国	1,469	1,355	8%	7%

**表 1：全球前十大晶圆代工厂（2021 年第一季度）**

排名	公司	国家或地区	1Q21E	1Q20	YOY	M/S
5	中芯国际	中国大陆	1,059	905	17%	5%
6	高塔半导体	以色列	345	300	15%	2%
7	力积电	中国台湾	340	283	20%	2%
8	世界先进	中国台湾	327	260	26%	1%
9	华虹半导体	中国大陆	288	203	42%	1%
10	东部高科	韩国	197	189	4%	1%

资料来源：集邦咨询，东莞证券研究所

- 马来西亚为全球电子生产重地，封锁全国将加剧电子行业缺货行情。**马来西亚为全球半导体重要生产基地，亦是日系、台系企业电阻产品制造重地。根据 PCB 资讯数据，约有 50 余家跨国半导体企业在马来西亚设厂，包括 intel、AMD、恩智浦、英飞凌、瑞萨和意法半导体等全球半导体巨头。由于半导体产业集群密集，因此马来西亚半导体封测业发达，相比其他东南亚国家具有举足轻重的地位。此外，马来西亚也是全球重要的被动元件生产基地，如华新科、奇力新有较大比例电阻产能在马来西亚、村田有部分 MLCC 和电感产能、松下有部分电感产能在马来西亚。若马来西亚疫情持续，预计将对全球半导体封测、被动元件产能造成一定影响，全球半导体缺货、涨价行情可能加剧。

**表 2：在马来西亚投资建厂的部分电子及半导体企业**

公司	工厂性质	说明
英飞凌	封测	晶圆制造、半导体芯片组装和测试
英特尔	封测	处理器在马来西亚当地有后段产能（约占 CPU 后段产能的 50%）
日月光	封测	专注于 IDM 厂及汽车电子芯片封测业务
意法半导体	封测	高效封装测试
华天科技	封测	收购 Unisem
通富微电	封测	收购 FABTRONIC SDN BHD
苏州固锴	封测	分两次完成了对 AICS 的收购
瑞萨	晶圆制造	主要负责处理器、芯片组和其他产品的封装与组装
环球晶圆	晶圆制造	6 寸晶圆厂
村田	电感、MLCC	生产电感及 MLCC

资料来源：PCB 资讯，东莞证券研究所

- 投资建议：维持推荐评级。**印度、马来西亚和中国台湾新冠疫情加剧，对大陆电子产业的影响应一分为二来看。一方面，海外疫情加剧对电子行业从供给、需求端均造成一定冲击，预计全球智能手机出货量相比年初市场预期将有所下调；另一方面，海外疫情发酵将加剧全球半导体的涨价缺货潮，海外供给受到制约，可能会导致部分成熟制程订单转移至大陆，或将加速集成电路和关键元器件的国产替代进程，建议关注中芯国际（688981）、风华高科（000636）、三环集团（300408）、士兰微（600460）、兆易创新（603986）等潜在受益企业。

**东莞证券研究报告评级体系：**

公司投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
中性	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
行业投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 5%-10%之间
中性	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上
风险等级评级	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	可转债、股票、股票型基金等方面的研究报告
中高风险	科创板股票、新三板股票、权证、退市整理期股票、港股通股票等方面的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

本评级体系“市场指数”参照标的为沪深 300 指数。

**分析师承诺：**

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

**声明：**

东莞证券为全国综合性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

**东莞证券研究所**

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：(0769) 22119430

传真：(0769) 22119430

网址：[www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)